



平成 22 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第1部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 辻本 圭一
(TEL 093-614-1111)

連結子会社に対する債権放棄のお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の連結子会社である Mitsui High-tec (Philippines) ,Inc.に対する債権を放棄することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 債権放棄の理由

当該子会社はすでに会社を清算する方向で準備を進めており、その手続きの一環として債権放棄を決定いたしました。

2. Mitsui High-tec (Philippines) ,Inc.の概要

- (1) 所在地 : 10 Binary St, Light Industry & Science Park1 Special Export Processing Zone
Bo Diezmo Cabuyao, Laguna 4025 Philippines
- (2) 代表者 : 西島 直宏
- (3) 資本金 : 9,999 千米ドル
- (4) 事業内容 : ICリードフレームの製造及び販売

3. 債権放棄の内容

- (1) 債権の種類 : 貸付金
- (2) 債権の金額 : 3,108 千米ドル並びに 127 百万円 (両債権合わせて約 4 億円)

4. 当社の業績に与える影響

当社は、平成 22 年 1 月期までに貸倒引当金を計上済みであり、平成 23 年 1 月期の連結業績及び個別業績に与える影響はありません。

以 上